

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部

成分表

製品名(鉛フリー): XB1085xxxxJR-G
標準質量: 320 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	2.376	シリコン	7400	7440-21-3
		- 砒素	<1	7440-38-2
リードフレーム	168.780	銅	527400	7440-50-8
		鉄	400	7439-89-6
		リン	100	7723-14-0
		銀	300	7440-22-4
ダイアタッチ	0.371	銀	1200	7440-22-4
		アクリル樹脂	200	—
		ポリブタジエン誘導体	100	—
		エポキシ樹脂	100	—
ボンディングワイヤ	0.191	金	600	7440-57-5
封止樹脂	123.848	溶融シリカ	387000	60676-86-0
		エポキシ樹脂	50600	—
		フェノール樹脂	22100	—
端子メッキ	0.812	錫	2500	7440-31-5

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、
開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 質量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせていただきます。